

2Е802А-5

биполярный транзистор
с изолированным затвором

Назначение

Бескорпусные кремниевые планарные биполярные с изолированным затвором, поставляемые на общей пластине (неразделенными). Предназначены для внутреннего монтажа в гибридных интегральных микросхемах (ГС), микросборках и блоках, а также для сборки дискретных приборов, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия света, влаги, соляного тумана, плесневых грибков, инея и росы, агрессивных газов и смесей. Транзисторы применяются для работы в ключевых устройствах аппаратуры специального назначения. Категория качества ВП.

Ближайший функциональный аналог

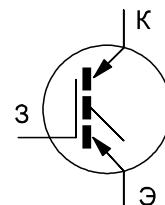
- аналог IRG4DC30

Обозначение технических условий

- АЕЯР.432140.321 ТУ

**Рабочий температурный диапазон**

- диапазон температур от - 60 до + 125 °C

**Конструктивное исполнение**

- крикетлы на общей пластине неразделенные

Требования к устойчивости при специальных воздействиях

- Специальные воздействия в составе ГС (микросборок) – по ОСТ В 11 336.018.
- Специальные воздействия И1, И2, И3, С3, К1, К3 по группе исполнения 1У.

Справочные данные

- 95-процентный ресурс транзисторов (T_{γ}) в режимах и условиях, допустимых ТУ, – 50000 ч.
- 95-процентный ресурс транзисторов (T_{γ}) в облегченных режимах и условиях – 100000 ч.

Физические характеристики кристалла

Диаметр пластины	(100 ± 0,5) мм
Толщина кристалла	(0,30 ± 0,02) мм
Размер кристалла	(5,0 x 5,0) мм
Пассивация	НТФСС
Металлизация планарной стороны	AL - Si (1%)
Металлизация непланарной стороны	V - Au

Координаты и размеры контактных площадок

№ площадки	Назначение	Координаты (левый нижний угол)		Координаты (правый верхний угол)	
		X (мм)	Y (мм)	X (мм)	Y (мм)
01	Эмиттер	1,6	2,784	3,4	4,584
02	Затвор	2,064	0,478	2,944	1,215

Примечание:

- Координаты даны по слою пассивация
- Размеры и шероховатость для справок
- НТФСС – низкотемпературное фосфоросиликатное стекло

Рисунок 1. Габаритный чертеж кристалла 2E802A-5

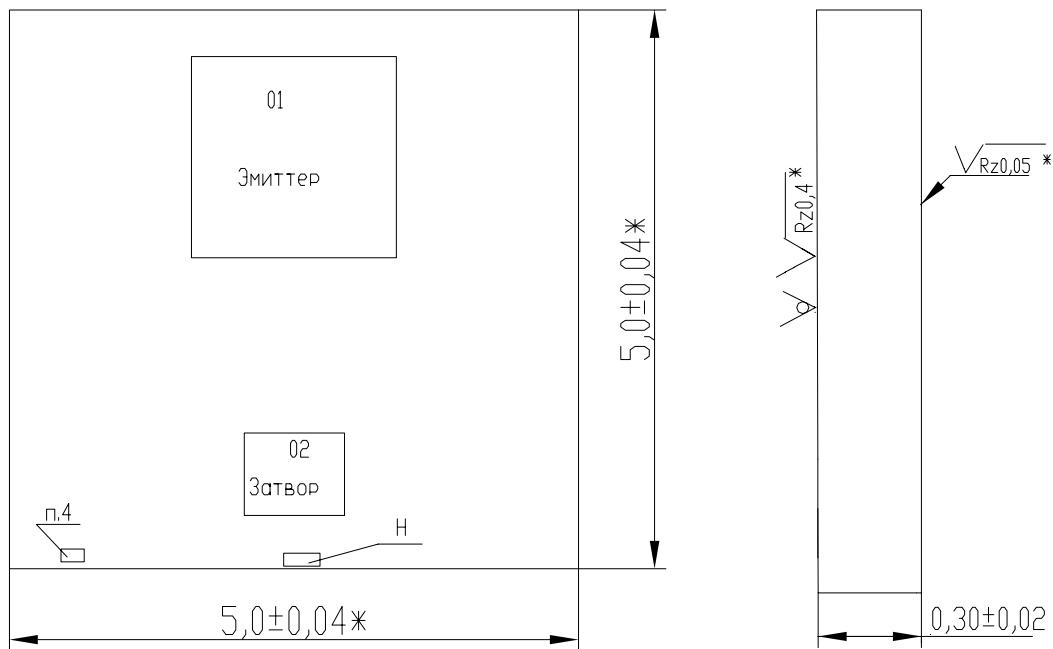


Таблица 1. Электрические параметры транзисторов при приемке и поставке

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °C
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{K\bar{E}} = 612$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$, $t_i = (0,3-10)$ мс, $Q \geq 50$), мА	$I_{K\bar{E}K}$	-	0,2	25 ± 10
Ток утечки затвора ($U_{3\bar{E}} = \pm 22$ В), нА	$I_{3\bar{E},ut}$	-	90	25 ± 10
Пороговое напряжение ($U_{K\bar{E}} = U_{3\bar{E}}$, $I_K = 1$ мА), В	$U_{3\bar{E},por}$	3,2	5,8	25 ± 10
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K = 5$ А, $U_{3\bar{E}} = 15$ В, $t_i = (0,3-3)$ мс, $Q \geq 50$), В	$U_{K\bar{E} nas}$	-	2,4	25 ± 10
Обратный ток коллектор-эмиттер* ($U_{K\bar{E}} = 600$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$) ($U_{K\bar{E}} = 600$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$) ($U_{K\bar{E}} = 500$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$) ($t_i = (0,3-10)$ мс, $Q \geq 50$), мА	$I_{K\bar{E}K}$	- - -	0,25 1,5 0,25	25 ± 10 125 ± 5 -60 ± 3
Ток утечки затвора* ($U_{3\bar{E}} = \pm 20$ В), нА	$I_{3\bar{E},ut}$	-	100	25 ± 10
Пороговое напряжение* ($U_{K\bar{E}} = U_{3\bar{E}}$, $I_K = 1$ мА), В	$U_{3\bar{E},por}$	3	6	25 ± 10
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер* ($I_K = 12$ А, $U_{3\bar{E}} = 15$ В, $t_i = (0,3-3)$ мс, $Q \geq 50$), В	$U_{K\bar{E} nas}$	- - -	2,7 3,5 3,5	25 ± 10 125 ± 5 -60 ± 3

* Параметры, нормы для которых установлены для транзисторов в составе ГС (микросборок).

Таблица 2. Электрические параметры транзисторов, изменяющиеся в течение наработки

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура корпуса, °C
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{K\bar{E}} = 600$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$, $t_i = (0,3-10)$ мс, $Q \geq 50$), мА	$I_{K\bar{E}K}$	-	0,5	25 ± 10

Таблица 3. Электрические параметры транзисторов в процессе и после воздействия специальных факторов

Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура корпуса, °C
		не менее	не более	
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{K\bar{E}} = 600$ В, $R_{3\bar{E}} = 0$, $t_i = (0,3-10)$ мс, $Q \geq 50$), мА	$I_{K\bar{E}K}$	-	0,5	25 ± 10
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K = 12$ А, $U_{3\bar{E}} = 15$ В, $t_i = (0,3-3)$ мс, $Q \geq 50$), В	$U_{K\bar{E} \text{ нас}}$	-	10	25 ± 10

Таблица 4. Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации транзисторов (в составе ГС) в диапазоне рабочих температур

Наименование параметра, режим и условия измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер*, В	$U_{K\bar{E}K \text{ max}}$	600
Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер*, В	$U_{K\bar{E}K, \text{ и max}}$	600
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер, В	$U_{3\bar{E} \text{ max}}$	± 20
Максимально допустимый постоянный ток коллектора ^{*1} , А	$I_K \text{ max}$	23
Максимально допустимый импульсный ток коллектора ^{*1} ($t_i = 2$ мкс), А	$I_K, \text{ и max}$	92
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора ^{*2, *3, *4} , Вт (при температуре корпуса от минус 60 до 25 °C)	$P_K \text{ max}$	100
Максимально допустимая температура перехода (кристалла) ^{*2} , °C	$T_{\text{пер max}}$	150
Тепловое сопротивление переход-корпус ^{*3} , °C/Вт	$R_{Y\text{пер-кор}}$	1,25

* В диапазоне температур корпуса от минус 40 до 125 °C. При снижении температуры корпуса до минус 60 °C напряжение снижается линейно до 500 В.

*¹ При условии непревышения $P_K \text{ max}$ для заданной температуры.

*² При сборке в условный корпус КТ-9.

*³ При температурах корпуса $T_{\text{кор}}$ (КТ-9) выше 25 до 125 °C $P_K \text{ max}$ рассчитывают по формуле

$$P_{K \text{ max}} = (150 - T_{\text{кор}})/1,25$$

*⁴ Максимально допустимую постоянную рассеиваемую мощность коллектора $P_K \text{ max}$, Вт транзисторов в составе ГС (микросборок, приборов) при температурах корпуса $T_{\text{кор}}$ от 25 до 125 °C рассчитывают по формуле

$$P_{K \text{ max}} = (T_{\text{пер max}} - T_{\text{кор}})/R_{Y \text{ пер-кор}}$$

где $R_{Y \text{ пер-кор}}$ – тепловое сопротивление переход-корпус конкретных ГС (микросборок, приборов). При температурах корпуса от минус 60 до 25 °C $P_K \text{ max}$ принимается равным величине, рассчитанной для температуры корпуса $T_{\text{кор}} = 25$ °C.

Таблица 5. Справочные значения основных параметров в составе ГС (микросборок) при $T_{кор} = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим и условия измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Значение параметра		
		Минимальное	Типовое	Максимальное
Обратный ток коллектор-эмиттер ($U_{КЭ} = 600$ В, $R_{3Э} = 0$, $t_i = (0,3-10)$ мс, $Q \geq 50$), мА	$I_{КЭК}$	-	-	0,25
Ток утечки затвора ($U_{3Э} = \pm 20$ В), нА	$I_{3,ут}$	-	-	100
Пороговое напряжение ($U_{КЭ} = U_{3Э}, I_K = 1$ мА), В	$U_{3Э,пор}$	3	-	6
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_K = 12$ А, $U_{3Э} = 15$ В, $t_i = (0,3-3)$ мс, $Q \geq 50$), В	$U_{КЭ нас}$	-	-	2,7
Время спада ($I_K = 12$ А, $U_{3Э} = 15$ В, $U_K = 100$ В, $R_3 = 15$ Ом, $t_i \leq 300$ мкс, $Q \geq 50$), нс	$t_{сп}$	-	-	150
Время рассасывания ($I_K = 12$ А, $U_{3Э} = 15$ В, $U_K = 100$ В, $R_3 = 15$ Ом, $t_i \leq 300$ мкс, $Q \geq 50$), мкс	$t_{рас}$	-	-	1,0

Таблица 6. Определения и буквенные обозначения электрических параметров, не установленных действующими стандартами

Наименование параметра	Буквенное обозначение	Определение
Затвор	-	Электрод транзистора, на который подается электрический сигнал
Обратный ток коллектор-эмиттер	$I_{КЭК}$	Ток в цепи коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер (при коротко замкнутых выводах эмиттера и затвора)
Пороговое напряжение	$U_{3Э,пор}$	Напряжение между затвором и эмиттером, при котором ток коллектора достигает заданного низкого значения
Максимально допустимое напряжение затвор-эмиттер	$U_{3Эmax}$	Максимально допустимое напряжение между выводами затвора и эмиттера
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	$U_{КЭнас}$	Напряжение между выводами коллектора и эмиттера в режиме насыщения при заданных токе коллектора и напряжении затвор-эмиттер
Время рассасывания	$t_{рас}$	Интервал времени между моментом подачи на затвор запирающего импульса и моментом, когда напряжение на коллекторе транзистора достигает заданного уровня
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер	$U_{КЭKmax}$	Максимально допустимое напряжение между выводами коллектора и эмиттера при коротком замыкании в цепи затвор-эмиттер

Требования к устойчивости при механических воздействиях

Механические воздействия в составе ГС (микросборок) по ОСТ В 11 336.018 со следующим уточнением:

- уровень звукового давления акустического шума 160 дБ.

Требования к устойчивости при климатических воздействиях

Климатические воздействия в составе ГС (микросборок) - по ОСТ В 11 336.018 со следующими уточнениями:

- повышенная рабочая температура среды (корпуса) 125 °C;
- смена температуры среды от минус 60 до 125 °C.

Требования к надежности

Минимальная наработка транзисторов в составе ГС (микросборок) в режимах и условиях, допускаемых настоящими ТУ, – 25000 ч, а в следующих облегченных режимах и условиях: при $P = 0,5 P_{Kmax}$, $T_{kor} = (125 \pm 5) ^\circ C$ – 50000 ч.

Срок хранения транзисторов до момента их герметизации в составе ГС (микросборок) по ОСТ В 11 336.018.

Минимальный срок сохраняемости в составе ГС (микросборок) – по ОСТ В 11 336.018.

Указания по применению и эксплуатации

Указания по применению и эксплуатации – по ОСТ В 11 336.018, ОСТ 11 336.907.0 и ОСТ 11 0272 с дополнениями и уточнениями, изложенными в настоящем разделе.

Основное назначение транзисторов – использование в неремонтируемых гибридных схемах, микросборках, блоках или дискретных приборах (имеющих герметичные корпуса или иную защиту от воздействия света, влаги, соляного тумана, плесневых грибков, инея и росы, агрессивных сред), предназначенных для работы в ключевых устройствах аппаратуры специального назначения.

При производстве ГС (микросборок) строго руководствоваться требованиями 5.4 ОСТ В 11 336.018 и ОСТ 11 0272. При извлечении из тары, проверке и в процессе эксплуатации бескорпусных транзисторов необходимо обеспечить защиту от воздействия статического электричества в соответствии с ОСТ 11 073.062. Допустимое значение статического потенциала 500 В, степень жесткости – IV.

После проведения операций: разделение на кристаллы, присоединение выводов и установка в корпус при соблюдении требований ОСТ В 11 336.018 и ТУ транзисторы должны соответствовать требованиям ОСТ В 11 336.018 и ТУ в течение времени минимальной наработки и сохраняемости.

При технологических операциях недопустимо попадание на поверхность транзисторов пыли, масел, жиров, графита, спирта и других загрязнений, особенно, токопроводящих. На всех стадиях производства и сборки транзисторов запрещается брать бескорпусные транзисторы незащищенными руками.

Предприятию-потребителю при производстве ГС (микросборок) необходимо проводить технологические (отраковочные) испытания согласно ОСТ В 11 0219.

Каждая пластина подлежит входному контролю только по внешнему виду.

Не допускается повторное присоединение вывода к контактной площадке.



ОАО "ИНТЕГРАЛ", г. Минск, Республика Беларусь

Внимание! Данная техническая спецификация является ознакомительной и не может заменить собой
учтенный экземпляр технических условий или этикетку на изделие.

ОАО "ИНТЕГРАЛ" сохраняет за собой право вносить изменения в описания технических характеристик
изделий без предварительного уведомления.

Изображения корпусов приводятся для иллюстрации. Ссылки на зарубежные прототипы не подразумевают
полного совпадения конструкции и/или технологии. Изделие ОАО "ИНТЕГРАЛ" чаще всего является
ближайшим или функциональным аналогом.

Контактная информация предприятия доступна на сайте:

<http://www.integral.by>